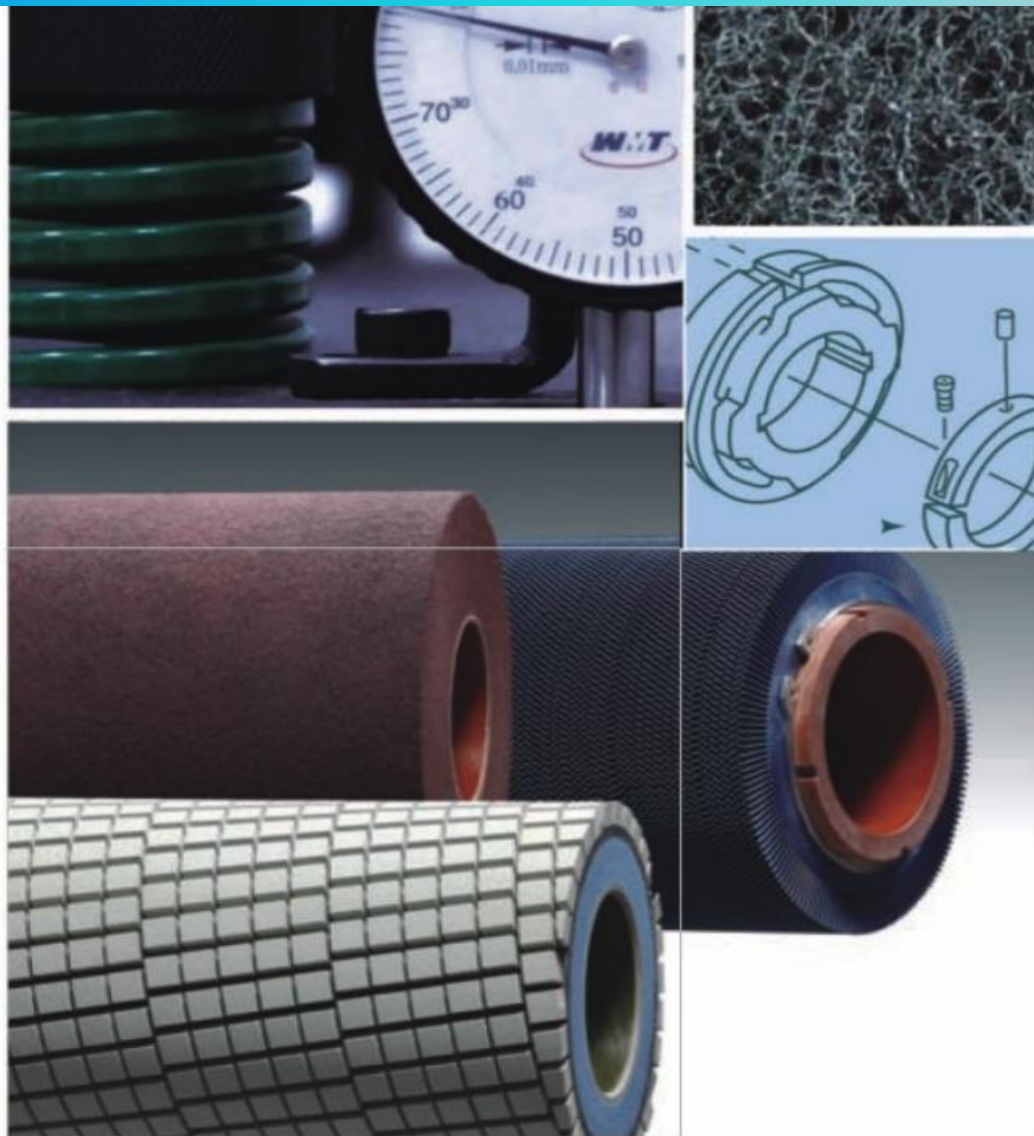


先端技術
品質保証



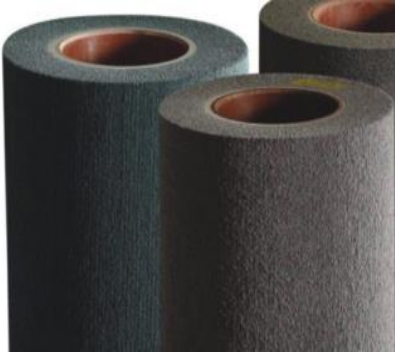
东莞市鼎泰鑫电子有限公司
DONGGUAN DINGTAIXIN ELECTRONICS CO.,LTD.



日本総代理店：
丹波貿易株式会社
Tel : 03-3901-6333
Mail: tamba@tamba-trading.com
Web: <https://tamba-trading.com/>

製品種類

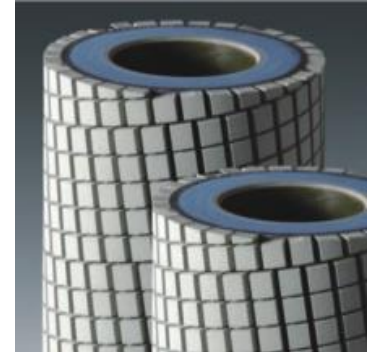
放射式研磨ロール：
HD、HC



ホイール研磨ロール：Leveling
Wheel(SFC、SC)



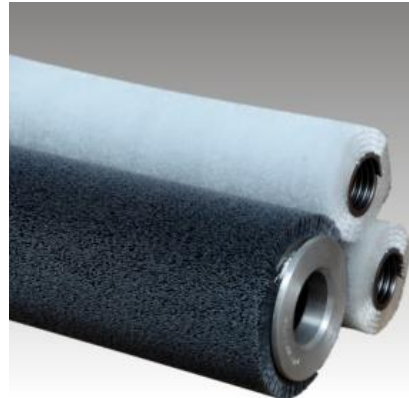
セラミックブラシ：CB、
CM、CD



FH研磨ロール



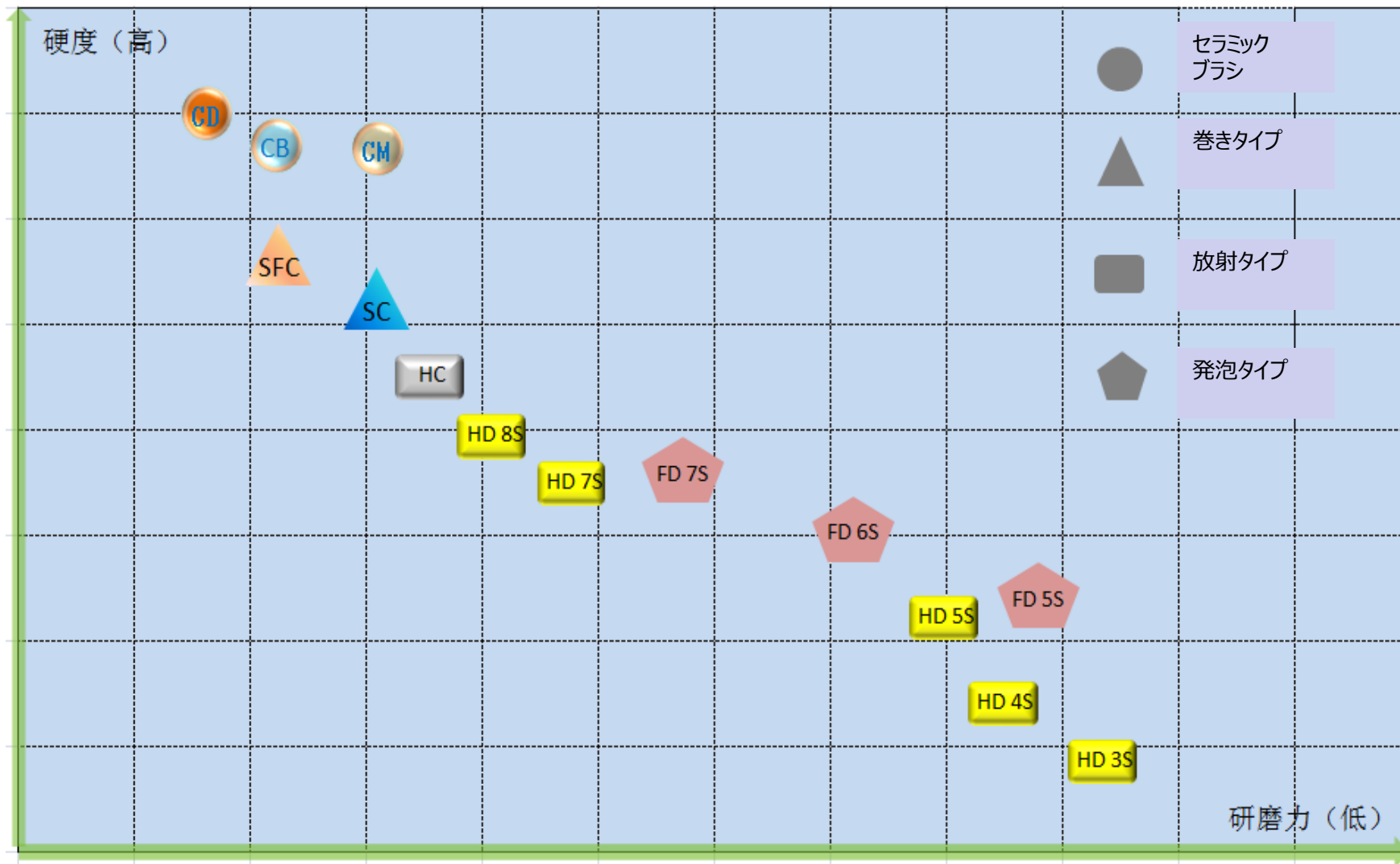
ナイロン研磨ロール



ベルトサンダー用研磨ベルト



ローラーブラシ性能図



※同粒度研磨材粒子各シリーズの研磨特性図

用途別おすすめ商品

プロセス	穴あけ	回路形成	ラミネート前	ソルダーレジスト前 処理	穴埋め	めっき前
用途	バリ取り、表面平滑化	銅粉除去。表面平滑化	樹脂除去、表面粗化	異物除去、表面平滑化	穴埋め樹脂研磨	異物除去
推薦（一）	HD	HC	HD	FD	CB、CM、CD	FD
推薦（二）	FD	SC、SFC	FD	HD	SFC、SC	ナイロン研 磨
その他	ナイロン研磨、FH	CB、CM、CD	ナイロン研磨	ナイロン研磨	HC	

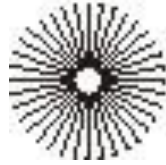
※研磨用途推薦

研磨材料種類		炭化ケイ素					
粒 度		400	600	800	1000	1200	1500
硬 度	2S	●	●	●	●	●	●
	S	●	●	●	●	●	●
	M	●	●	●	●	●	●
	H	●	●	●	●	●	●

※お客様のご要望に応じて、ブラシ硬度粒度のカスタマイズが可能です。

不織布ブラシの構造・仕様

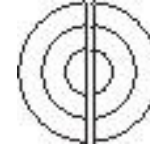
構造：



フラップタイプ

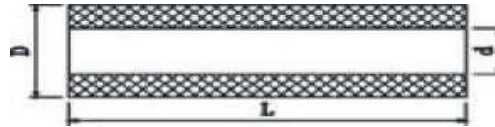


ホイールタイプ



半割タイプ

仕様：



粒度	240#	320#	400#	500#	600#	800#	1000#	1200#
D(inch)	3、4、4.5、5、6、8、10、12、14							
d(mm)	25.4、32、50.8、76.2、100、150							
L(mm)	450	550	610	650	670	710	1200	1350
硬度	(ソフト) S (ハード) M (スーパーハード) H							

注：お客様の装置やご要望に応じて、サイズや粒度のカスタマイズが可能です

HD 高密度フラップブラシ (HD Flap Brush)

高密度不織布ブラシは放射状構造のブラシ製品です、優れた研磨力と安定した加工ができます。

プリント基板の研磨工程で最も汎用性の高い製品です。

HD flap brushes are made of tightly compressed , resin bonded non-woven flaps .
This construction provides excellent cleaning performance and consistent surface finish.



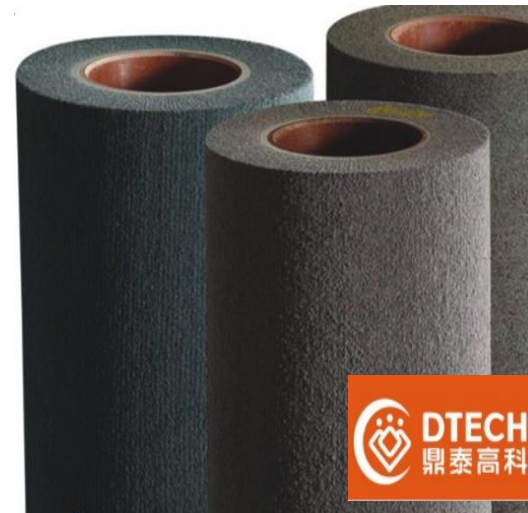
- 用途
- 穴あけ後のバリ取り
- ラミネート前の表面粗化
- ソルダーマスク前の整面
- 穴埋めインク除去
- SUS中間板の樹脂除去



粒度 (Grit)	#320,#400,#600, #800,#1000,#1500
--------------	-------------------------------------

Main Application

- Deburring after drilling through hole
- Cleaning Before Dry Film Lamination
- Cleaning Before Solder Masking
- Hole Plugging Ink Removal
- S/S Press Board Cleaning



HC高切削カフラップブラシ (High-cut Brush)

高切削力の不織布ブラシは、特殊な砥粒を使用し、フェノール樹脂で補強したフラップブラシです。

通常のブラシよりも研磨力が優れており、特に高い研磨力が必要な工程に適しています。

High-Cut Buff is made of of tightly compressed, resin bonded non-woven flaps. It

provides increased cutting ability than normal brushes , and used for



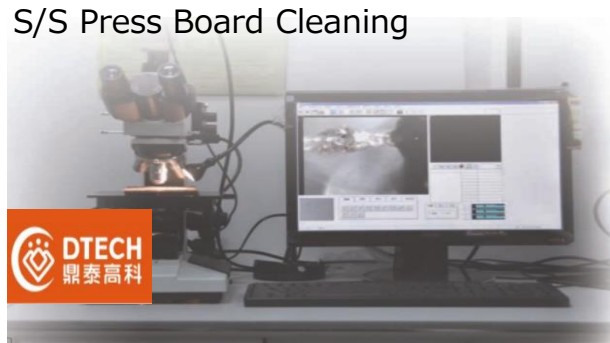
用途

- めっき後銅粉の除去
- 穴埋めインの除去
- 黒化処理后レジンの除去
- SUS中間板の洗浄

粒度 (Grit)	#320, #400, #600, #800
--------------	---------------------------

Main Application

- Copper Particle Removal
- Hole Plugging Resin Removal
- Prepreg resin removal with black oxide
- S/S Press Board Cleaning



Leveling Wheel巻き式ブラシ (Leveling wheel Brush)

高研磨力ホイールブラシは、HDI基板製造プロセス用に特別に設計されたもので、より高い表面研磨力を持ち、研磨均一性良く、優れた樹脂除去性能があります。

Convolutd Type High Cutting Brush is specially designed for HDI application It

Provide the best cutting performance and uniform surface finishing.



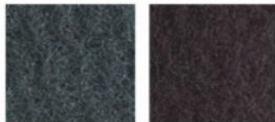
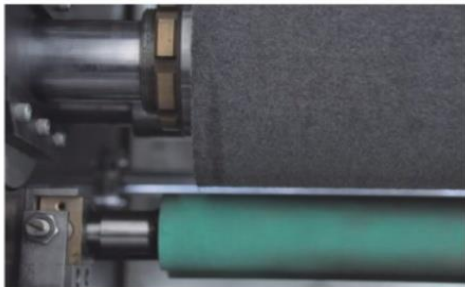
用途

- 穴埋めインク除去
- 銅めっき後銅粉の除去

粒度 (Grit)	#400, #600,
--------------	-------------

Main Application

- Hole Plugging Resin Removal
- Copper Particle Removal

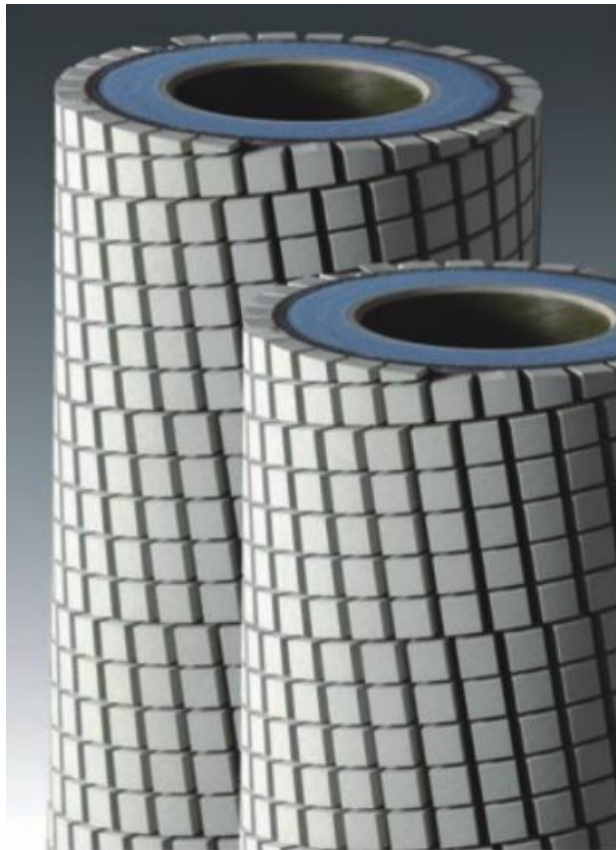


セラミックブラシ (Ceramic Brush)

プリント基板製造工程における高研磨工程用に設計されたセラミックブラシで、ブラシの中で最も高い研磨力を有しています。

高効率と高品質のブラシです。

Ceramic Brush is designed for the high cutting performance applications, it provides the highest cutting performance, better efficiency and quality.



用途

- 銅メッキ後の銅粉除去
- 穴埋め樹脂の除去
- ビルドアップ工法における樹脂被膜の平滑化

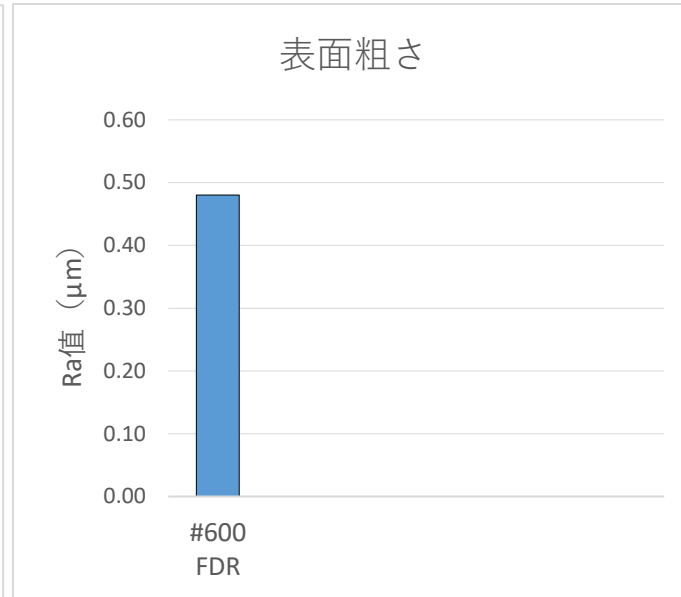
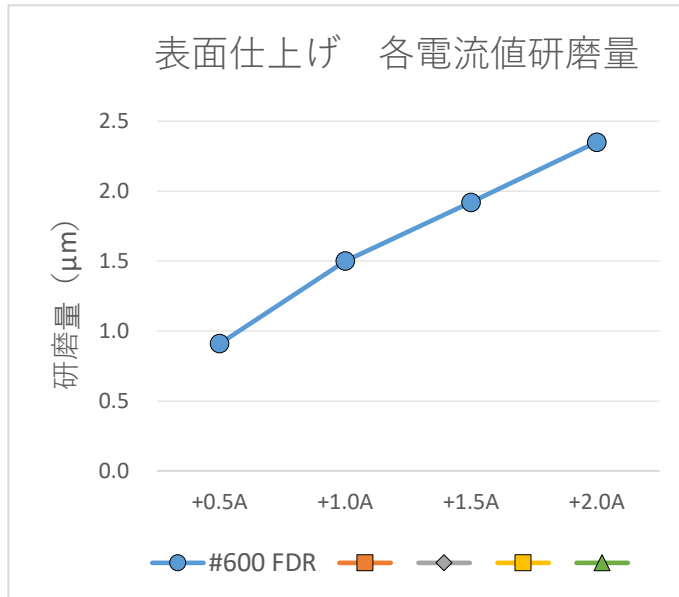
粒度 (Grit)	#320, #400, #600, #800, #1000, #1200, #1500, #2000
--------------	---

Main Application

- Copper Particle Removal
- Hole Plugging Resin Removal
- Resin Layer Leveling in Building Up Process.



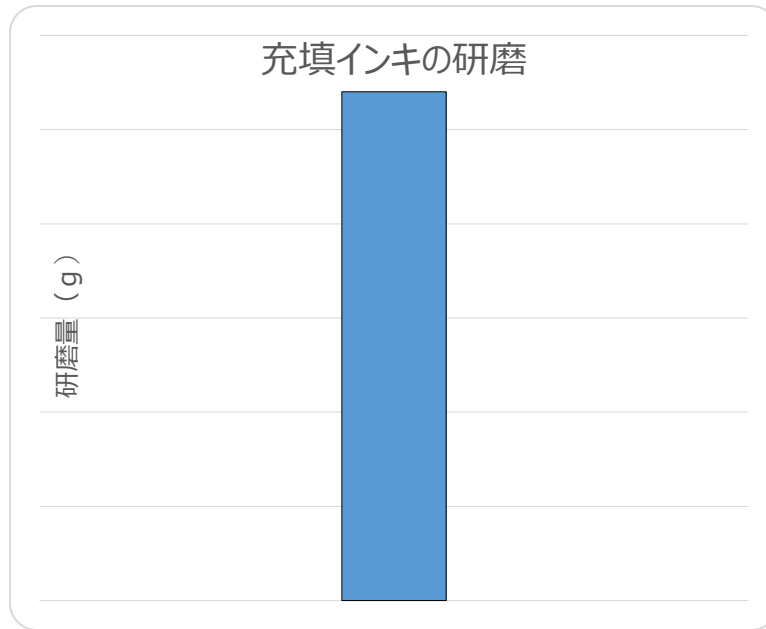
用途	穴埋めインク研磨剤（ペースト、インク）		充填後ビルドアップ層の平滑化用					回路形成後の平面研磨加工	
研磨の目的・ポイント	従来のインク充填基板を除く、恒久的なインク充填基板や積層基板の芯材にエポキシ樹脂の絶縁樹脂や導電性ペーストを充填した基板の研磨用です。穴の周りに付着している余分な樹脂を取り除くのが目的です。焦点：高い研磨力を持ち、穴の潰れない平滑な表面を仕上げます。		ビルドアップ層のレーザー貫通孔を研磨することにより、銅めっき後の導体の厚みを制御し、平滑に表面仕上げができます。ポイント：高い研磨力と均一性があります。					回路（銅）と絶縁樹脂の両面を研磨することで、平滑で均一な仕上がりが得られます。ポイント：連続した研磨を維持し、均一で、きめ細かい仕上がりを得ることができます。	
お勧め	セラミックブラシ		セラミックブラシ					セラミックブラシ	
製品	形状	硬度範囲	粒度					特徴	
			1 #400	2 #600	3 #800	4 #1000	5 #1500		
	セラミックブラシ	スポンジ硬度 15 or 30度	○	○	○	○	○	スポンジコアの弾性をそのまま伝える構造で高い研磨能力を持ち、高精度な標準偏差を可能にする。	



測定条件：

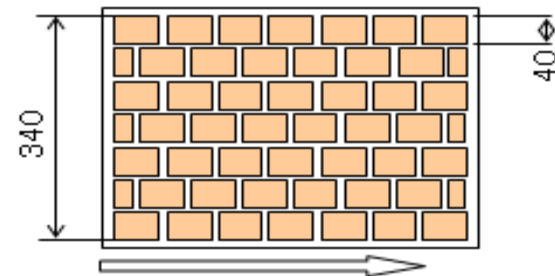
ワーク：銅張り積層板0.8 x 406 x 500-35 μ m
 (研磨幅500mm)
 ブラシ回転速度：848m/min(回転数一定)
 転送速度：1.5m/min

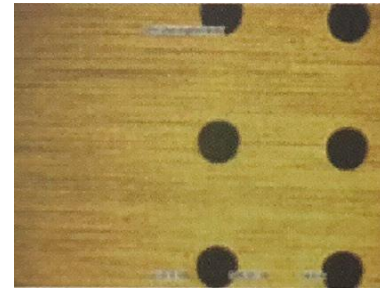
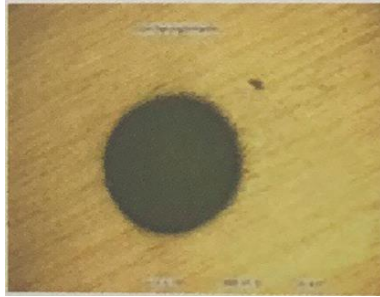
研磨量	+0.5A	+1.0A	+1.5A	+2.0A
#600	0.91	1.5	1.92	2.35



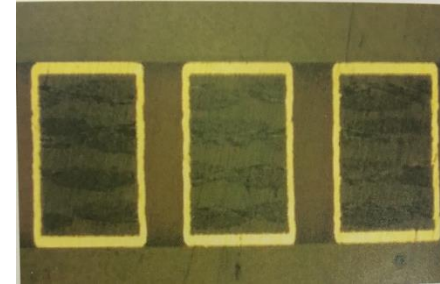
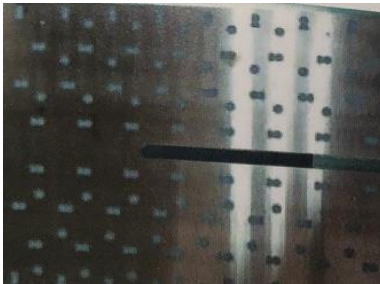
測定条件:

インク：太陽インク THP-100 DX--1
研磨ロール回転速度：848m/min(回転速度一定)
研磨パワー：1.0A
転送速度：1.5m/min





貫通孔の形状変化への影響はなく、開口穴の銅へのダメージもない。



充填穴の形状に変化なし，表面の銅メッキは無傷，表面平滑；

谢谢!